

Interscale Flexible Heat Conductor (FHC), 20 mm

Power Utilities



Conductor block expands/contracts vertically to compensate for tolerance stack up and optimizes surface contact and pressure along the thermal path; eliminates the need for a thermal gap pad.

CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Designed for Intel, AMD, Via, Freescale, NVidia and Texas Instrument processors that employ a BGA socket

Provides industry-leading conduction cooling performance, 10% improvement over current conduction cooling methods

Patent pending conduction cooling solution for small form factor electronics

Secured to PCB with thermally conductive adhesive tape

Conductor block expands/contracts vertically to compensate for tolerance stack up and optimizes surface contact and pressure along the thermal path; eliminates the need for a thermal gap pad

Compatible with Interscale C enclosures

SPECIFICAȚII

Table 1/1

Număr de catalog	Type	Works With	Package Quantity	Depth	Width
------------------	------	------------	------------------	-------	-------

24830-005	Heat Conductor	Cases	1	22 mm	22 mm
-----------	----------------	-------	---	-------	-------

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE